

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ИК-650ПРО

Технические и конкурентные преимущества
Возможности программы «Термопро-Центр»

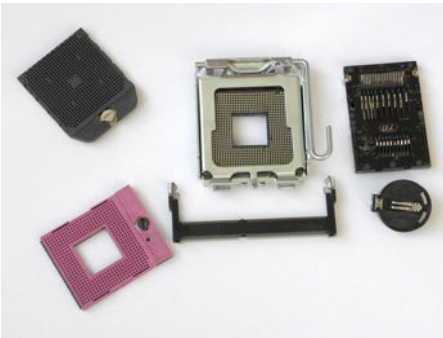
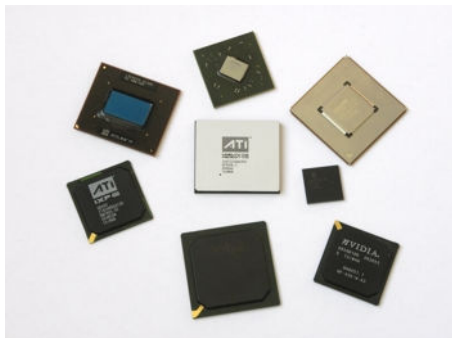


КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА паяльной станции ИК-650 ПРО

1. Паяльная станция ИК-650 ПРО - экономически выгодное готовое решение для 99% случаев бережного ремонта печатных плат ноутбуков, видеоприставок таких как XBOX-360, материнских и серверных печатных плат, плат телевизоров, мониторов, смартфонов, планшетных компьютеров, фотоаппаратов, а также плат промышленного, коммуникационного и другого сложного оборудования.
2. ИК станция подходит как для профессионалов, так и для начинающих мастеров.
3. ИК-650 ПРО – это лучшее соотношение цена / качество и лучший функционал на рынке ИК станций для пайки BGA.
4. Быстрая окупаемость ИК станции при BGA пайке.
5. ИК станция за четыре года получила широкое распространение в России и СНГ. Во всех крупных городах России с населением более 250.000 человек, а таких городов 75, работают по несколько станций ИК-650 ПРО.
6. Для принятия решения о приобретении нашей ИК станции рекомендуем просмотреть отзывы профессиональных пользователей ИК-650ПРО.
7. ИК-650 ПРО это заводское качество изготовления, длительный срок службы и самая долгая гарантия.
8. Видимо ИК-650 ПРО это единственная ИК паяльная станция в России которая сертифицирована как паяльное оборудование соответствующее ГОСТу РФ.
9. Возможность купить паяльную станцию ИК-650 ПРО по частям или в рассрочку.
10. ИК-650 ПРО поднимет качество вашей пайки BGA на профессиональный уровень. При соблюдении рекомендуемой технологии результат пайки будет 100% положительный.
11. Для мелкосерийного и единичного монтажа плат станция ИК-650 ПРО дает двойное преимущество. Вы получаете в свои руки не только возможность пайки BGA и других сложных микросхем, но и отличный инструмент для групповой пайки SMD - компонентов на печатные платы по термопрофилю. Качество пайки обеспечивается на уровне камерных и конвейерных печей оплавления, а с 2012 года еще и в режиме обратной связи по температуре платы (можно паять сразу практически без настройки, естественно немного потренировавшись).
12. Инфракрасная паяльная станция ИК-650 ПРО постоянно совершенствуется. В результате пользователи получают возможность постепенно наращивать свои возможности, приобретая новые блоки. В настоящее время ведутся работы по разработке видеоустановщика для точного позиционирования BGA относительно посадочного места на печатной плате.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИК-650ПРО

1. Термопрофилирование с обратной связью по термодатчику на печатной плате обеспечивает отличную повторяемость техпроцесса. Такая функция имеется только у дорогостоящих паяльных станций европейского производства. Отработка термопрофиля не зависит от типа платы, коррекция температуры платы осуществляются станцией «на лету» автоматически.



2. Пайка микросхем BGA - CBGA, CCGA, PBGA, μ BGA, FCBGA, LFBGA, CGA, CSP, QFN, QFP, MLF, PGA и других чипов размером до 60х60мм, а также пластиковые коннекторы перепаяют на паяльной станции ИК-650про без признаков перегрева.
3. Точная цифровая система измерения температуры обеспечивает 100% гарантию результата. В ИК-650 ПРО встроенная система измерения температуры является полным аналогом сертифицированного средства измерения военного назначения ТЕРМОСКОП ТА-570М.
4. Точная система автоматической стабилизации температуры с памятью и обратной связью поддерживает температуру нагревателей ИК станции на строго заданном значении.
5. Воздушный охладитель печатных плат формирует зону охлаждения термопрофиля с поддержкой заданной скорости, что способствует правильной кристаллизации припоя и повышает надежность паяного соединения.
6. ИК станция ИК-650 ПРО может быть укомплектована инновационными 3D концентраторами ИК лучей для верхнего нагревателя. По сравнению с плоскими диафрагмами и регулируемые окнами 3D концентраторы обеспечивают:
 - Улучшение равномерности теплового поля в зоне пайки BGA
 - Уменьшение размера теплового пятна в зоне пайки BGA
 - Улучшение обзора и удобства доступа к зоне пайки BGA
7. Видеоконтроль процесса пайки с помощью USB микроскопа, а также автоматическая запись процесса оплавления в видеофайл.
8. ИК станция поддерживает технологию безсвинцовой пайки.
9. ИК станция поддерживает технологию перекачки шариков BGA (ребол) как по термопрофилю, так и в ручном режиме.
10. ИК-650 ПРО не требует калибровки на всем сроке эксплуатации.

11. ИК станция комплектуется бесплатной программой управления с самым богатым функционалом.
12. Верхний нагреватель Elstein излучает волны в невидимом спектре. ИК спектр в диапазоне 2-8µm обеспечивает равномерный нагрев разнородных материалов с соблюдением необходимой скорости нагрева в соответствии с требованиями производителей микросхем и паяльных паст.
13. ИК станция комплектуется лазером для точного прицеливания в центр при BGA пайке.
14. ИК Станция оснащается уникальными широкоформатными термостолами с двумя зонами нагрева. Термостолы высокой энерговооруженности обладают нормированным распределением температуры по поверхности. Такой термостол гарантированно обеспечивает равномерный и быстрый подогрев по термопрофилю, исключая деформацию многослойных печатных плат. Также возможна работа станции с любыми термостолами серии НП меньших габаритов.
15. В отличие от интегрированной, модульная компоновка инфракрасной паяльной станции ИК-650 ПРО обеспечивает полный равномерный подогрев платы, даже в тех случаях, когда перепаяваемый чип расположен на самом краю. При этом практически отсутствуют ограничения на расположение больших печатных плат в рабочей зоне. В станции ИК-650 ПРО применяется подвижный телескопический штатив с четырьмя степенями свободы, который обеспечивает быстрое позиционирование верхнего нагревателя в любую точку печатной платы.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ТЕРМОПРО-ЦЕНТР»

1. Полное цифровое управление всеми режимами работы ИК паяльной станции в автоматическом и ручном режимах.
2. Автоматическая пайка BGA по заданному термопрофилю в режиме обратной связи с одновременным графическим отображением температуры всех нагревательных и контрольных каналов. В результате получаем одинаковый результат при BGA пайке различных плат по одному термопрофилю без всяких настроек.
3. Автоматическая групповая пайка SMD по термопрофилю в режиме обратной связи (для единичного и мелкосерийного производства).
4. Автоматическое охлаждение платы после пайки с заданной скоростью.
5. Неограниченное количество термопрофилей для BGA пайки.
6. "Горячий старт" в режиме термопрофилирования для ускорения BGA пайки подогретых плат.

7. Поддержкой видеоконтроля процесса пайки BGA с помощью USB видеокамеры или видеомикроскопа встроенным модулем «BGA-ВИДЕО». При этом имеется возможность автоматической записи видеофрагмента с момента начала процесса оплавления.
8. Стабилизация температуры платы при паузе в режиме термопрофилирования для упрощения процесса снятия герметика при отпайке BGA.
9. Возможность ручной корректировки температуры платы при паузе в режиме термопрофилирования.
10. Хранение результатов BGA пайки с сохранением исходного техпроцесса в архиве. Восстановление техпроцесса из архива результатов пайки одним нажатие кнопки.
11. Программируемый режим аудиовизуального оповещения об этапах BGA пайки и режим аудиовизуального оповещения при отклонении от техпроцесса.
12. Одновременная поддержка до 4-х регуляторов температуры.
13. Поддержка измерителя температуры Термоскоп ТА-570М увеличивает число контрольных термодатчиков ИК станции до четырех.
14. Режим графического отображения температуры всех нагревательных и контрольных каналов при работе инфракрасной паяльной станции в ручном режиме.
15. Режим графического самописца для долговременного мониторинга температуры по контрольным термодатчикам станции ИК-650 или измерителя температуры Термоскоп ТА-570М.
16. Возможность подключения регуляторов температуры к компьютеру через порты COM или USB (через переходник COM / USB или встроенный в регулятор температуры преобразователь интерфейсов.)
17. Возможность термопрофилирования нагрева на всех моделях термостолов серий НП и ИКТ.